

S3X70-HF1100-3 (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 5
 S3X811-M500-6 (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type 6



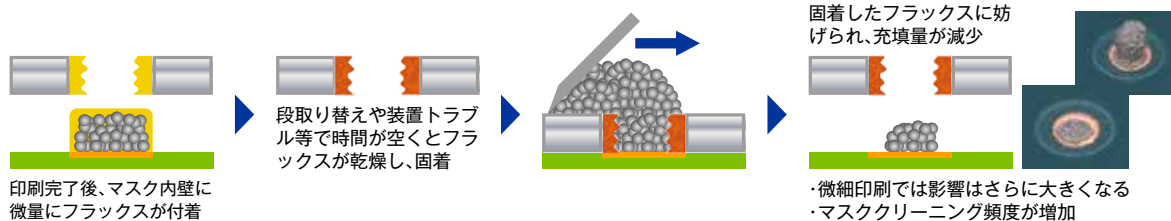
ファインピッチ印刷対応ソルダーペースト

- 超小型チップの実装を可能とした抜群の印刷特性です。
- 微細印刷に対応したはんだ粒径で、はんだボールの発生を抑え安定した実装が可能です。

溶剤の揮発を抑えてフラックス乾燥トラブルを防止

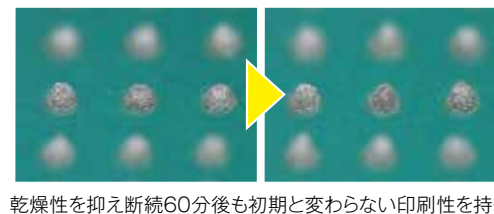
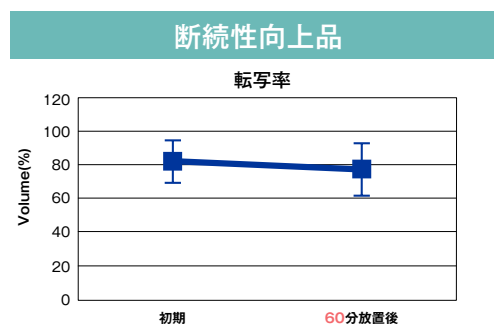
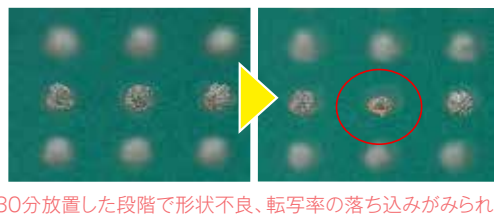
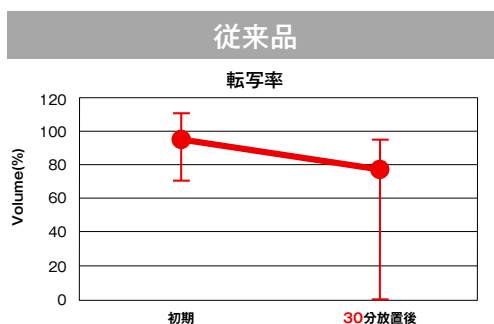
不揮発性の高い溶剤を主成分とし、乾燥の影響を受けにくいように断続印刷性を向上させました。断続後にも初期と同等の印刷性、作業性を維持し、トラブル発生時のコスト増を防止します。

■印刷時の不具合ケース

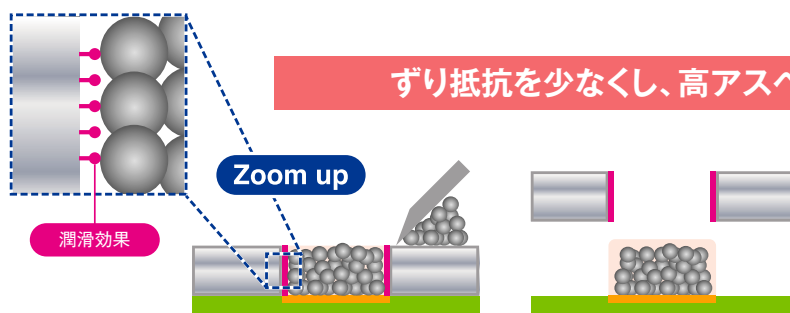


■断続印刷特性

- ・基板材質：FR-4
- ・スキージ：メタルスキージ、60°
- ・メタルマスク厚：80μm
- ・印刷速度：40mm/sec
- ・評価箇所：0.18mmφCSP
- ・印刷後メタルマスクを放置し、放置後の印刷転写率を測定



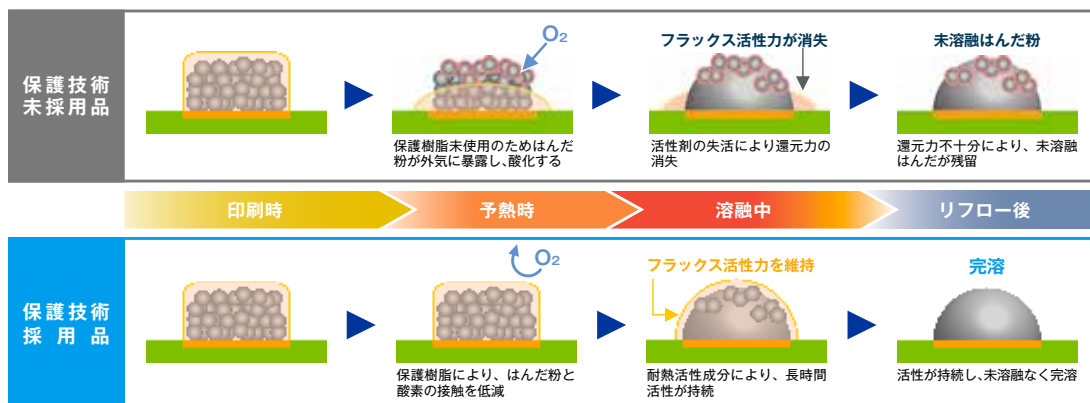
ずり抵抗を少なくし、高アスペクト比印刷が可能



印刷時にメタルマスクの壁面に滑剤が配位し、マスク側面の抵抗を低減。版離れ時の摩擦力が減少し、ずり抵抗が小さくなることで、高い版抜け性が得られます。

微細はんだ粉を酸化から守り、確実に溶融

■フラックスによるはんだ粉保護技術



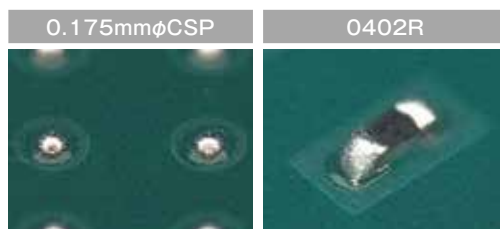
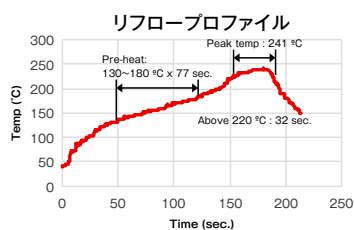
フラックスに高軟化点樹脂を使用し、予熱時のフラックスの滲みとダレを抑制してはんだ粉を保護することで予熱時の酸化を抑制します。

S3X70-HF1100-3

0402サイズ部品への良好なはんだ付け性を実現

■リフローテスト

- 基板材質 : FR-4
- 評価箇所 : 0.175mmφCSP、0402R
- パッド表面処理 : Cu-OSP処理
- メタルマスク厚 : 80μm
- 開口率 : 100%
- 加熱装置 : エアーリフロー (N₂)



製品名	S3X70-HF1100-3
合金組成 (%)	Sn 3.0Ag 0.5Cu
融点 (°C)	217 - 219
粒径 (μm)	10 - 25
ハライド含有量 (%)	0
フラックスタイプ	ROLO (IPC J-STD-004C)
シェルフライフ (<10°C)	6ヶ月

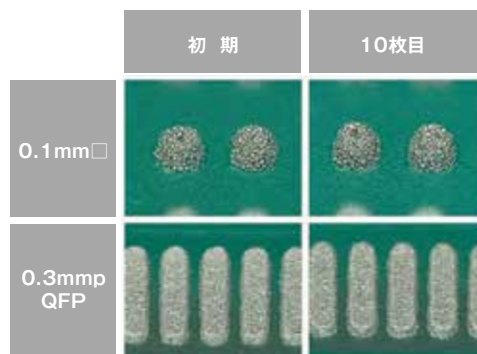
はんだ粉末の未溶融もなく、良好な濡れを実現。

S3X811-M500-6

0201チップ実装における超微細パターンでの確実な印刷性を実現

■高密度印刷特性テスト

- 基板材質 : FR-4
- メタルマスク厚 : 50μm
- 評価箇所 : 0.1mm□、0.3mmp QFP
- スキージ : メタルスキージ、60°
- 印刷速度 : 50mm/sec
- 加熱装置 : N₂リフロー



製品名	S3X811-M500-6
合金組成 (%)	Sn 3.0Ag 0.5Cu
融点 (°C)	217 - 219
粒径 (μm)	5 - 20
ハライド含有量 (%)	0
フラックスタイプ	ROLO (IPC J-STD-004B)
シェルフライフ (<10°C)	6ヶ月

ツノ立ちの発生も太りもなく、安定した印刷形状。